

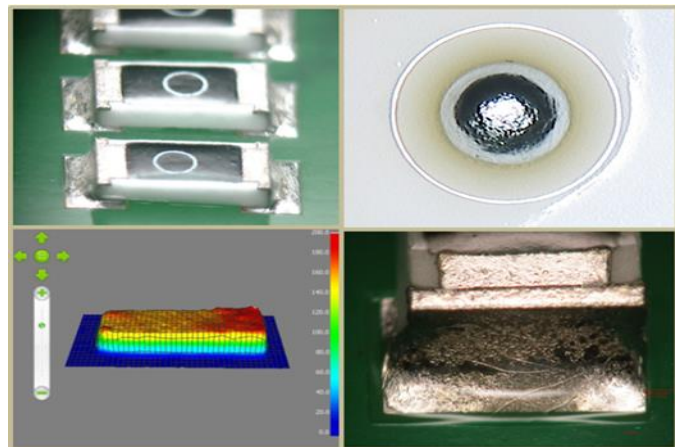
## PASTA PARA SOLDAR QUE NO NECESITA LIMPIEZA NC259

### CARACTERÍSTICAS

- Menor formación de vacíos
- Menos defectos de deformación
- Grandes capacidades de pausar para imprimir
- Definición precisa de impresiones pequeñas
- Excelente humectación con aleaciones sin plata o con poca plata
- Extremadamente pocos residuos
- Velocidades de impresión de hasta 6"/s (150 mm/s)

### DESCRIPCIÓN

La pasta para soldar NC259 de AIM se desarrolló para uso con aleaciones sin plata o con poca plata al mismo tiempo que conservan el rendimiento de aleaciones SAC con alto contenido de plata. NC259 demuestra capacidades de pausar para imprimir de > 8 horas mientras brinda alta eficiencia de transferencia y definición de impresión precisa. El sistema activador de NC259 promueve la humectación incluso en ausencia de plata y tolera temperaturas pico de reflujo de hasta 260°C. Cuando se combina con SN100C®, NC259 produce uniones de soldadura brillantes y lisas, y muestra baja formación de vacíos en paquetes BGA y BTC. Los residuos mínimos después del proceso se mantienen transparentes incluso a las elevadas temperaturas requeridas para aleaciones sin plomo.

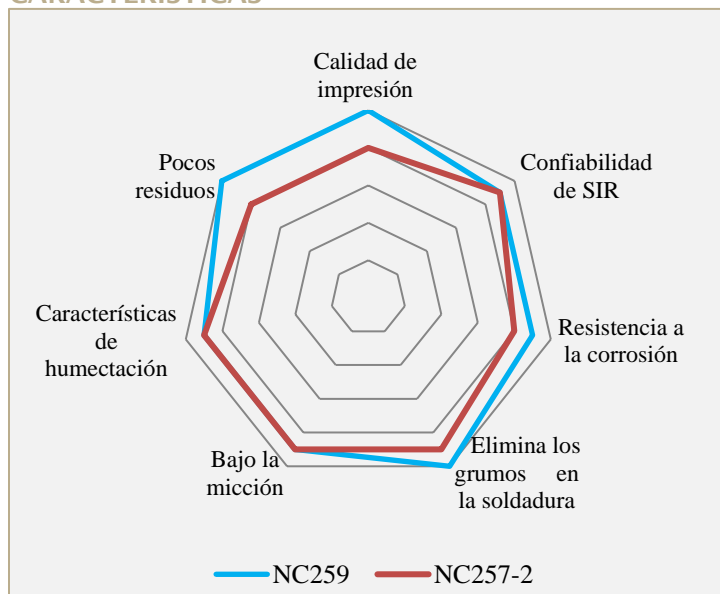


### MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Parámetro	Hora	Temperatura
Vida en almacenamiento sellado	9 meses	0°C-12°C (32°F-55°F)

No agregar pasta usada a pasta sin usar. Almacenar la pasta usada por separado; mantener la pasta sin usar sellada herméticamente con un tapón interno o tapa de extremo colocados. Consultar las pautas de la pasta de AIM para obtener más información. La aleación y las condiciones de almacenamiento pueden afectar la vida útil. Consulte el Certificado de Análisis de NC259 para información específica del producto.

### CARACTERÍSTICAS



### LIMPIEZA

Antes del reflujo: DJAW-10 de AIM elimina con eficacia la pasta para soldadura NC259 de plantillas durante el proceso. Se puede aplicar DJAW-10 manualmente o usarse debajo del equipo de limpieza de las plantillas. DJAW-10 no secará la pasta NC259 y mejorará las propiedades de transferencia. No aplicar DJAW-10 en exceso. No aplicar DJAW-10 a la parte superior de las plantillas. No se recomienda el uso de isopropanol (IPA) en el proceso, pero se puede usar como enjuague final de las plantillas.

Residuo de fundente después del reflujo: Los residuos de NC259 pueden permanecer en el conjunto después del reflujo y no requieren limpieza. Para cuando sea obligatorio limpiar, AIM trabajó estrechamente con socios de la industria para asegurarse de que los residuos de NC259 se puedan eliminar con eficacia con agentes removedores de fundente comunes.

Comuníquese con AIM para obtener información sobre la compatibilidad de limpieza.



## PERFIL DE REFLUJO


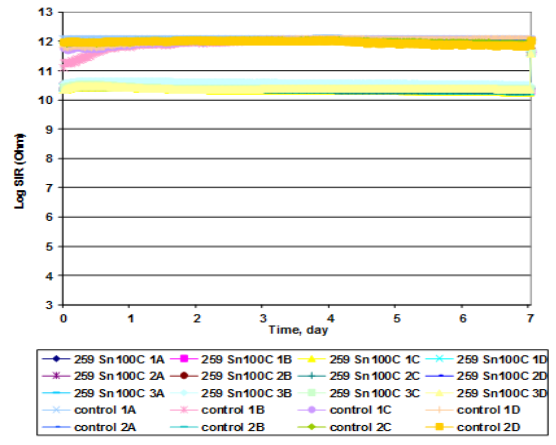
Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

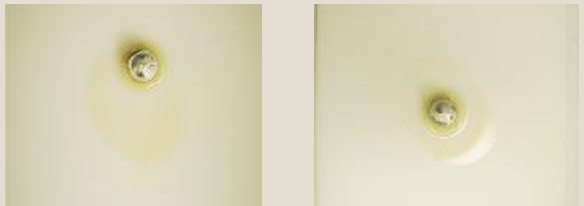
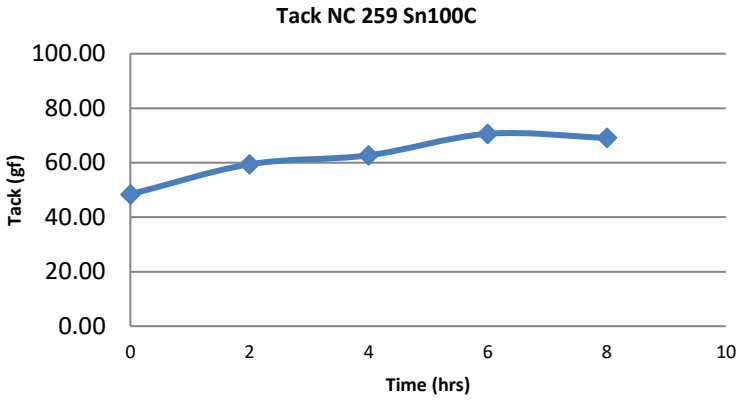
## IMPRESIÓN

Los Ajustes Iniciales Abajo Recomendados Son Dependientes Del Diseño Del PCB Y PAD	
Parámetro	Configuración Inicial Recomendada
Presión de la Boquilla	0.9 -1.5 lbs/pulgada de la navaja
Velocidad de la Boquilla	0.5 - 6 pulgada/segundo
Distancia de Desprendimiento	Al Contacto 0.00 mm
Distancia de Separación del PCB	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Separación del PCB	3 - 20 mm/segundo

## DATOS DE PRUEBA

Nombre	Método de Prueba	Resultados	
Clasificación IPC	J-STD-004	ROLO	
Clasificación IPC	J-STD-004B 3.3.1	ROL1	
Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Espejo de Cobre	J-STD-004B 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Corrosión	J-STD-004B 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	
Haluros cuantitativos	J-STD-004B 3.4.1.3 IPC-TM-650 2.3.28.1	PASA	

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen
Cualitativa Haluros, Cromato de Plata	J-STD-004B 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Cualitativa Haluros, Fluoruro Punto	J-STD-004B 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	
Resistencia Aislante de la Superficie	J-STD-004B 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Migración electroquímica	J-STD-004B 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Sólidos del fundente, determinación de no volátiles	J-STD-004B 3.4.2.1 IPC-TM-650 2.3.34	95.6% Tipico	
Valor Ácido Determination	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	150 +/- 4 mg KOH/ g flux Tipico	
Gravedad específica del flux	J-STD-004B 3.4.2.3 ASTM D-1298	3.70 Tipico	
Viscosidad	J-STD-005A 3.5.1 IPC-TM-650 2.4.34	500 - 1000 Kcps	
Visual	J-STD-004B 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa	
Prueba de Slump de la Soldadura en Pasta	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	

Nombre	Método de Prueba	Resultados	Imagen												
Bola de soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA													
Fuerza de Adhesion	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	48g Típico	 <table border="1"> <caption>Tack NC 259 Sn100C</caption> <thead> <tr> <th>Time (hrs)</th> <th>Tack (gf)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>68</td> </tr> </tbody> </table>	Time (hrs)	Tack (gf)	0	48	2	60	4	62	6	70	8	68
Time (hrs)	Tack (gf)														
0	48														
2	60														
4	62														
6	70														
8	68														
Prueba de Wetting	J-STD-005A 3.9 IPC-TM-650 2.4.45	PASA													